

电子

行业研究/周报

硅片涨价与扩产并进, 功率半导体高景气持续

一电子周报 20211011

电子周报 2021 年 10 月 11 日

报告摘要:

● 市场整体上涨, 半导体下跌1.28%

上周 (2021/10/8) 市场整体上涨,半导体指数下跌 1.28%。其中:半导体设计-1.2%、半导体制造+1.6%、半导体封测+1.7%、半导体材料+0.4%、半导体设备-2.8%、功率半导体-3.3%。

上周费城半导体指数小幅下跌,跌幅为 0.46%, 2021/1/1-2021/10/8 涨幅为 16.12%。台湾半导体指数上周上涨 0.11%, 2021/1/1-2021/10/8 涨幅为 11.91%。截至上周(2021/10/8),A股半导体公司总市值达 30,919 亿元,同比+12%,对应 2021 年整体 PE为 57 倍。

上周(2021/10/8)半导体行业涨幅前五公司为扬杰科技(+8.73%)、三安光电(+7.57%)、深科技(+4.77%)、兆易创新(+3.25%)和东软载波(+2.93%),涨幅后五的公司为瑞芯微(-4.79%)、华峰测控(-6.24%)、乐鑫科技(-6.36%)、紫光国微(-6.69%)和斯达半导(-9.90%)。

● 半导体制造:下游客户囤货,美国白宫要求代工厂提供库存等经营信息

全球疫情在局部地区反复,供应链安全遭到冲击,各环节出现囤积芯片现象。台积电发货给下游智能手机和游戏机的芯片数量超出其终端产品出货量的实际需求,使代工产能紧缺进一步恶化。9月23日,白宫称为提高芯片供应链透明度、解决瓶颈环节,要求三星电子、台积电、英特尔等半导体制造商在11月8日前提供三年销售情况、原材料和设备采购情况、客户信息以及当前库存水平。一旦提供相应信息,代工厂在议价过程中将处于不利位置,在一定程度能够打击某些厂商的囤货行为,芯片涨价节奏与幅度或将得到缓解。但考虑到这一过程的缓慢进展以及供应链环节之间的传递时滞,涨价抑制效应预计最早也将在2022年显现。

半导体材料:部分封装材料厂商因"能耗双控"暂时停产,硅片扩产与涨价齐

- 1) 短期冲击:在"能耗双控"的政策下,恩智浦、英飞凌和日月光的半导体封装材料供应商长华科技在9月26日晚间至9月底停工,再次加剧半导体供应紧张;
- 2)长期紧缺:材料环节硅片严重紧缺,长单价格只升不降。根据沪硅产业数据,目前8英寸硅片产能缺口为30万/月-50万片/月,12英寸硅片的缺口更甚。下游厂商通过签订长单锁定硅片产能,保障硅片的稳定供给,沪硅产业的硅片订单已经排到2023年底。今年硅片价格涨幅超过15%,硅片长期协议约定未来硅片厂商可以根据市场情况涨价,长单只能"保产不保价"。同时,产业内预计未来5年硅片需求依然强劲,2025年国内12英寸大硅片月需求量将达到200万片,是2020年的2倍。为满足国内半导体硅片需求,内资厂商均在大力扩展12英寸硅片产能。沪硅产业全资子公司--上海新昇计划2025年在临港实现100万片/月12英寸大硅片产能;今年年底,中环股份、立昂微分别计划实现17万片/月、15万片/月的12英寸硅片产能。

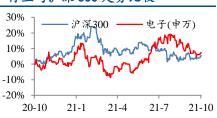
● 功率半导体:扬杰科技Q3业绩预计大增,向上整合硅片业务

1) 新品表现突出驱动业绩大增。10月8日,扬杰科技发布Q3业绩预告,21Q3单季实现归母净利1.94-2.33亿元,同增64-97%,按区间中值计算,21Q3单季预计实现归母净利2.14亿元,同增81%,环增13%;剔除非经常性损益后,21Q3单季预计实现扣非归母净利1.88亿元,同增67%,环增4%。主要因功率半导体行业高景气,国产替代加速,公司实现份额提升与满产满销;同时加大研发力度,MOS、小信号、IGBT及模块等新产品的业绩同比增速均在100%以上。

推荐

维持评级

行业与沪深 300 走势比较



资料来源: Wind, 民生证券研究院

分析师: 王芳

执业证号: S0100519090004 电话: 021-60876730

邮箱: wangfang@mszq.com

分析师: 杨旭

执业证号: S0100521050001 电话: 021-60876730

邮箱: yangxu_yj@mszq.com

分析师: 王浩然

执业证号: S0100521040001 电话: 021-60876730

邮箱: wanghaoran@mszq.com

研究助理: 赵晗泥

执业证号: S0100120070021 电话: 021-60876730

邮箱: zhaohanni@mszg.com

相关研究

1.【民生电子】行业点评:新能源车销量 超预期,高景气长周期开启

2.【民生电子】半导体周跟踪:产业趋势 向上明确,短期波动不改高景气



- 2)下游需求高景气,公司内部高端产品助力结构升级。电动车、新能源等领域高速发展,带动功率半导体需求持续增长,产业呈现需求强劲-产能满产-库存低位的格局,我们预计行业高景气趋势仍将持续。另一方面,公司持续加大研发投入,全力推进高端 MOS、小信号、IGBT 等高端产品的研发及产业化,进一步优化产品结构,带动整体效益提升。
- 3)向上游环节延伸,提升整体盈利能力。近日公司公告与四川雅安经开区签署《项目投资协议书》,计划总投资不低于7亿元用于投建半导体单晶材料扩能项目,项目分三期投资建设,计划5年内建成。项目建成后将扩充公司单晶硅棒、单晶硅抛光片、单晶硅外延片产能,强化公司上游硅片的自主能力,完善产业链布局,提升整体盈利水平。

● 重点新闻

- 1) 北方华创 10 月 8 日公布 2021 年前三季度业绩预告。第三季度营收预计 22 亿元 30 亿元,同比高增 30% -80%。
- 2) 9 月存储器现货价格跌幅趋缓,但合约价的补跌现象浮上台面。美光认为,第 4 季度 DRAM 与 NAND 维持量价齐升,但由于 PC OEM 客户遭遇零组件短缺,预期 1Q22 营收下滑。
- 3) 瑞萨: 车用 MCU 产能, 到 2023 年提升 50%以上。
- 4) 荷兰光刻机巨头阿斯麦 (ASML) 周三大幅上调了财务预测,并且表示,由于市场对其产品的需求旺盛,预计到 2030年,公司营收将以每年 11%左右的速度增长。

● 投资建议

持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业:

- 1)设计:看好景气持续下价格持续上涨的弹性标的,建议关注韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子、中颖电子、恒玄科技、芯海科技、圣邦股份、思瑞浦、乐鑫科技、汇顶科技等;
- 2) 功率:产能紧张&涨价持续,高景气趋势仍将持续。建议关注斯达半导、士兰微、中车时代电气、华润微、扬杰科技、新洁能、闻泰科技、捷捷微电等;
- 3)设备:景气持续下代工厂/封测厂扩产+国产替代下国内存储厂扩产,建议关注北方华创、 芯源微、华峰测控、中微公司、芯基微装等;
- 4) 材料:建议关注雅克科技、安集科技、鼎龙股份、江丰电子、华特气体、金宏气体等;
- 5) 代工:产能持续满载+国产替代,建议关注中芯国际、华虹半导体;
- 6) 封测:产能持续满载,建议关注长电科技、通富微电、深科技、华天科技等。

● 风险提示

下游代工厂扩产进度可能不及预期、国内厂商先进技术发展可能不及预期、行业景气度持续不及预期。



盈利预测与财务指标

盆利坝侧-	重点公司	现价	EPS			PE			270 800
代码		10月8日	2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	评级
603501. SH	韦尔股份	236	3. 12	5. 19	6. 95	76	46	34	推荐
603986. SH	兆易创新	150	1. 32	2. 92	4. 21	113	51	36	推荐
300782. SZ	卓胜微	359	3. 22	6. 51	8. 70	112	55	41	推荐
300671. SZ	富满电子	111	0. 49	4. 85	7. 08	227	23	16	推荐
688608. SH	恒玄科技	254	1. 65	4. 33	5. 82	154	59	44	推荐
688595. SH	芯海科技	94	0. 89	0. 99	1.99	105	95	47	推荐
300661. SZ	圣邦股份	322	1. 23	2. 26	3.06	262	142	105	NA
688536. SH	思瑞浦	632	2. 30	4. 25	6. 33	275	149	100	NA
688018. SH	乐鑫科技	196	1. 30	3. 53	4. 86	151	55	40	推荐
603160. SH	汇顶科技	112	3. 63	2. 48	3. 41	31	45	33	推荐
600460. SH	士兰微	56	0. 05	0. 67	0.86	1182	84	65	推荐
688396. SH	华润微	70	0. 73	1. 88	2. 19	96	37	32	推荐
300373. SZ	扬杰科技	48	0. 74	1. 41	1.82	66	34	27	NA
603290. SH	斯达半导	367	1. 13	2. 18	3. 03	325	169	121	推荐
605111. SH	新洁能	123	0. 98	2. 78	3. 25	125	44	38	推荐
688187. SH	时代电气	49	1. 75	1. 60	2. 04	28	31	24	推荐
600745. SH	闻泰科技	96	1. 94	2. 68	3. 64	49	36	26	推荐
300623. SZ	捷捷微电	32	0. 38	0. 66	0.84	84	49	38	NA
002371. SZ	北方华创	353	1. 08	1. 66	2. 36	327	213	150	NA
688200. SH	华峰测控	522	3. 25	6. 70	9. 67	161	78	54	推荐
688012. SH	中微公司	154	0.80	0. 90	1. 15	193	171	134	推荐
688037. SH	芯源微	233	0. 58	1. 10	1.99	401	213	117	推荐
688630. SH	芯碁微装	55	0. 59	0. 92	1.27	94	60	44	推荐
002409. SZ	雅克科技	75	0. 87	1. 28	1.72	86	59	43	推荐
688019. SH	安集科技	240	2. 89	2. 87	3. 95	83	84	61	NA
300666. SZ	江丰电子	43	0. 65	0. 76	1.00	66	56	43	NA
603650. SH	形程新材	48	0. 69	0. 85	1.09	70	57	44	推荐
688268. SH	华特气体	78	0. 89	1. 28	1.70	88	61	46	推荐
688106. SH	金宏气体	25	0. 41	0. 53	0.66	61	47	38	推荐
300054. SZ	鼎龙股份	19	-0.17	0. 32	0. 45	-113	61	43	NA
688981. SH	中芯国际	56	0. 55	1. 32	1.46	102	42	38	推荐
1347. HK	华虹半导体	39	0. 59	0. 98	1. 22	66	40	32	NA
600584. SH	长电科技	32	0. 73	1. 29	1.54	44	25	21	NA
002156. SZ	通富微电	19	0. 25	0. 68	0.89	76	29	22	推荐
000021. SZ	深科技	15	0. 55	0. 54	0. 67	27	27	22	推荐
002185. SZ	华天科技	12	0. 26	0. 43	0. 53	48	28	23	NA

资料来源: Wind、民生证券研究院

注:韦尔股份、兆易创新、卓胜徽、富满电子、恒玄科技、芯海科技、乐鑫科技、汇顶科技、士兰微、华润微、扬杰科技、斯达半导、新洁能、时代电气、闻泰科技、华峰测控、中微公司、芯源微、芯基微装、雅克科技、形程新材、华特气体、金宏气体、中芯国际、通富微电、深科技采用民生证券预测值,其他公司采用 wind 一致预期。



目录

1	行情回顾:市场整体上涨,半导体下跌 1. 28%	.5
2	行业新闻	10
	目录	
	目录	
12/10	H 🌣	U

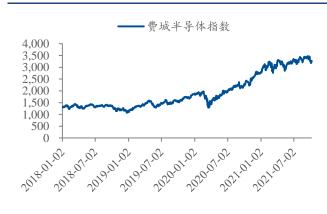


1 行情回顾:市场整体上涨,半导体下跌 1.28%

上周 (2021/10/8) 市场整体上涨, 沪深 300 指数上涨 1.31%, 上证综指上涨 0.67%, 深证成指上涨 0.73%, 创业板指数下跌 0.04%, 中信电子上涨 0.99%, 半导体指数下跌 1.28%。 其中: 半导体设计-1.2%、半导体制造+1.6%、半导体封测+1.7%、半导体材料+0.4%、半导体设备-2.8%、功率半导体-3.3%。

上周费城半导体指数小幅下跌, 跌幅为 0.46%, 2021/1/1-2021/10/8 涨幅为 16.12%。台湾半导体指数上周上涨 0.11%, 2021/1/1-2021/10/8 涨幅为 11.91%。

图 1: 费城半导体指数持续上涨



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 2: 全球半导体月度销售额及增速



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 3: A 股半导体指数



资料来源: wind, 民生证券研究院

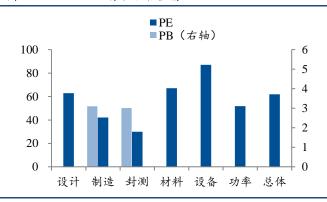
图 4: 台湾半导体指数



资料来源: wind, 民生证券研究院

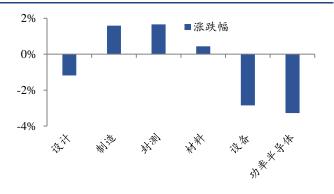


图 5: 2021-10-8 细分板块估值情况



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 6: 上周半导体各细分板块涨跌幅情况

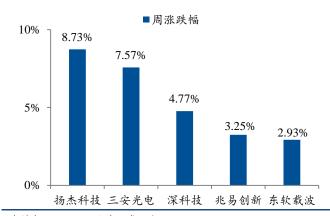


资料来源: wind, 民生证券研究院

- 注: PE=最近市值/2021 年 wind 一致预期净利润
- 注: PB=最近市值/2021 年 wind 一致预期净资产

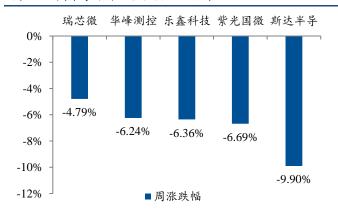
上周 (2021/10/8) 半导体行业涨幅前五公司为扬杰科技 (+8.73%)、三安光电 (+7.57%)、深科技 (+4.77%)、兆易创新 (+3.25%) 和东软载波 (+2.93%), 涨幅后五的公司为瑞芯微 (-4.79%)、华峰测控 (-6.24%)、乐鑫科技 (-6.36%)、紫光国微 (-6.69%) 和斯达半导 (-9.90%)。

图 7: 上周半导体行业涨跌幅前五公司



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 8: 上周半导体行业涨跌幅后五公司

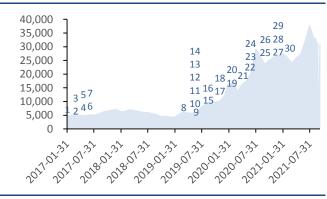


资料来源: wind, 民生证券研究院



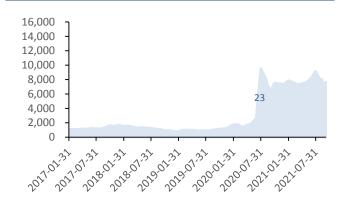
截至上周 (2021/10/8), A 股半导体公司总市值达 30,919 亿元, 同比+12%。其中:设计板块公司总市值 12,100 亿元, 同比+16.1%;制造板块公司总市值 7,650 亿元, 同比+3.9%;设备板块公司总市值 5,040 亿元, 同比+43.5%;材料板块公司总市值 4,331 亿元, 同比+21.7%;封测公司总市值 1,799 亿元, 同比-17.6%。

图 9: A 股半导体板块公司总市值(十亿元)



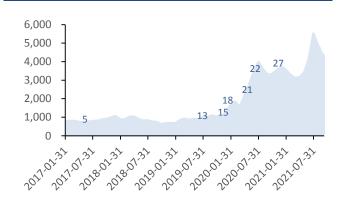
资料来源: wind, 民生证券研究院

图 11: A 股半导体设制造块公司总市值(十亿元)



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 13: A 股半导体材料板块公司总市值(十亿元)



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 10: A 股半导体设计板块公司总市值(十亿元)



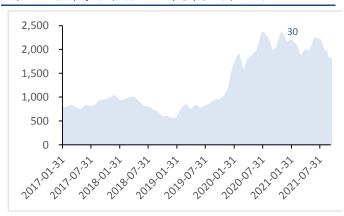
资料来源: wind, 民生证券研究院

图 12: A股半导体设备板块公司总市值(十亿元)



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 14: A 股半导体封测板块公司总市值(十亿元)



资料来源: wind, 民生证券研究院



- 注 1: 2017/2/20 富瀚微 (300613. SZ) 上市 (影响当月市值 63 亿)
- 注 2: 2017/4/17 长传科技 (300604. SZ) 上市 (影响当月市值 26 亿)
- 注 3: 2017/5/4 韦尔股份 (603501. SH) 上市 (影响当月市值 95 亿)
- 注 4: 2017/6/6 圣邦股份 (300661. SZ) 上市 (影响当月市值 44 亿)
- 注 5: 2017/6/15 江丰电子 (300666. SZ) 上市 (影响当月市值 42 亿)
- 注 6: 2017/7/12 国科微 (300672. SZ) 上市 (影响当月市值 32 亿)
- 注 7: 2017/7/28 中科信息 (300678. SZ) 上市 (影响当月市值 12 亿)
- 注8: 2019/4/15 博通集成 (603068. SH) 上市 (影响当月市值 69 亿)
- 注 9: 2019/6/18 卓胜微 (300782. SZ) 上市 (影响当月市值 111 亿)
- 注 10: 2019/7/22 乐鑫科技 (688018. SH) 上市 (影响当月市值 132 亿)
- 注 11: 2019/7/22 澜起科技 (688008. SH) 上市 (影响当月市值 874 亿)
- 注 12: 2019/7/22 中微公司 (688012. SH) 上市 (影响当月市值 473 亿)
- 注 13: 2019/7/22 安集科技 (688019. SH) 上市 (影响当月市值 103 亿)
- 注 14: 2019/8/8 晶晨股份 (688099. SH) 上市 (影响当月市值 358 亿)
- 注 15: 2019/11/20 清溢光电 (688138. SH) 上市 (影响当月市值 41 亿)
- 注 16: 2019/12/16 芯源微 (688012. SH) 上市 (影响当月市值 62 亿)
- 注 17: 2019/12/23 聚辰股份 (688123. SH) 上市 (影响当月市值 87 亿)
- 注 18: 2019/12/26 华特气体 (688268. SH) 上市 (影响当月市值 53 亿)
- 注 19: 2020/2/7 瑞芯微 (603893. SH) 上市 (影响当月市值 240 亿)
- 注 20: 2020/2/18 华峰测控 (688200. SH) 上市 (影响当月市值 155 亿)
- 注 21: 2020/4/20 沪硅产业-U (688126. SH) 上市 (影响当月市值 398 亿)
- 注 22: 2020/6/16 金宏气体 (688106. SH) 上市 (影响当月市值 262 亿)
- 注 23: 2020/7/16 中芯国际 (688981. SH) 上市 (影响当月市值 6115 亿)
- 注 24: 2020/7/22 芯朋微 (688508. SH) 上市 (影响当月市值 176 亿)
- 注 25: 2020/8/10 敏芯股份 (688286. SH) 上市 (影响当月市值 72 亿)
- 注 26: 2020/8/18 芯原股份-U (688521. SH) 上市 (影响当月市值 560 亿)
- 注 27: 2020/9/11 立昂微 (688126. SH) 上市 (影响当月市值 393 亿)
- 注 28: 2020/9/21 思瑞浦 (688536. SH) 上市 (影响当月市值 203 亿)
- 注 29: 2020/9/28 芯海科技 (688595. SH) 上市 (影响当月市值 62 亿)
- 注 30: 2020/11/11 利扬芯片 (688135. SH) 上市 (影响当月市值 78 亿)



上周(2021/10/8)沪/深股通总体减持半导体板块。沪/深股通持股市值前20的企业中,8家企业获增持,12家企业被减持。增持金额前三公司为三安光电(2.7亿元)、中环股份(1.6亿元)、圣邦股份(0.8亿元)、减持金额前三公司为韦尔股份(-7.8亿元)、北方华创(-1.6亿元)、士兰微(-1.2亿元)。

图 15、沪/深股通半导体板块持仓情况(按持股市值排名)

本周排名	上周排名	证券代码	证券简称	一周增減持金額 (百万元)	一月增减持金額 (百万元)		今增减持金額 百万元)	沪(深)股通持股市值 (百万元)	沪(深)股通持股占自 由流通股比例 %
1	1 🕏	603501. SH	韦尔股份	-776. 9547885	-1539. 951461		6015. 065837	15541.05	12. 3810383
2	2 🦈	002371. SZ :	北方华创	-155. 5969948	-728. 9122438		841.1490735	8293. 45	10.81859579
3	3 🦈	300782. SZ	卓胜微	-114. 2341134	22. 2013042		9303. 058279	7854. 36	11. 0877796
4	4 🦈	603986. SH	兆易创新	11. 73189067	697. 0416679		4215. 48243	7397. 51	9. 948945172
5	5 🦈	002008. SZ	大族激光	-68. 07454124	-285. 9522711	- [-161. 3035775	5732. 32	18. 64084317
6	6 🧇	002129. SZ	中环股份	156. 1189284	-523. 6151184		1348. 418947	5193. 58	5. 197312036
7	7 🦈	600745. SH	闻泰科技	-47. 60523099	77. 23336377		2273. 708336	4500.33	6. 954897714
8	8 🦈	300316. SZ	晶盛机电	-42. 11888953	-88. 87420539		2452. 390301	4254. 02	11.82317197
9	9 🦈	300661. SZ :	圣邦股份	82. 48850447	440. 4606614		2103. 036275	4206. 41	11. 68064306
10	10 🦈	600703. SH .	三安光电	272. 5536957	-291. 1929842		519. 7098931	4067. 42	5. 374332352
11	11 🕏	002049. SZ	紫光国微	15. 89076446	69. 9081569		1252. 855021	3022. 56	3. 751265968
12	12 🦈	603290. SH 🗦	斯达半导	27. 13163098	1141. 532412			2731.56	13. 35251269
13	14 🁚	688012. SH	中微公司	-19. 08431893	214. 1128427			1617. 27	4. 18365836
14	15 🧌	688008. SH	澜起科技	4. 603933955	128. 1711262			1565. 45	6. 142729762
15	13 🌵	600460. SH -	士兰徽	-115. 2003159	-338. 1057861	1	152. 7758851	1543. 53	3. 456667617
16	17 👚	300223. SZ	北京君正	15. 2710344	399. 4166384		1032. 615814	1343. 43	5. 722908566
17	16 🏺	600584. SH	长电科技	-19. 53208832	-97. 29612487		1389. 821686	1339. 31	3. 530084012
18	18 🦈	300458. SZ	全志科技	-22. 92979627	-133. 6615073		693. 6721039	1295. 30	8. 38542687
19	19 🦈	300327. SZ	中颖电子	-8. 270006973	-171. 2715016		771. 8910159	1290. 01	8. 545786998
20	20 🦈	603160. SH	汇顶科技	-5. 440724332	-91. 53363084	1	-86. 49405577	1130. 49	4. 523844661

注:此表中沪(深)股通持股市值=沪(深)股通持股数量*上周交易均价,数据更新截止于 2021/10/8; 资料来源:wind,民生证券研究院



2 行业新闻

上周重要新闻:

1) 台积电: 绝不会交出客户机密资料

上个月美国商务部在白宫召开半导体峰会,邀集半导体及汽车大厂等业者讨论全球芯片短缺 议题,会后美国商务部希望企业自主提供数据,找出芯片缺货关键并解决问题。业界传出,美 国政府希望台积电、三星等提供库存及销售纪录等机密资料。

为此台积电法务长方淑华6日强调,台积电绝对不会泄漏客户机密资料,至于是否提供资料目前还在评估。

同时,台湾当局行政部门负责人苏贞昌在受访时表示,台湾与美国的沟通管道非常顺畅,台当局也会强力支持台湾的相关产业。

苏贞昌表示,台湾芯片业者 "可以不用向美国提交芯片生产相关资料 ",并表示理解这是对全球普遍性的作为,并非单纯针对台湾企业。他说道:"这是自愿性的没有强迫,我们也会提供强劲支持。"

2) 格罗方德启动 IPO

10月5日,美国当地时间10月4日,全球第三大芯片制造厂商格罗方德(GlobalFoundries)申请在美国纳斯达克上市,代码为"GFS"。

格罗方德在 IPO 申请文件中还披露了公司营运财务数据。2018 年-2020 年,格罗方德营收分别为 61.96 亿美元、58.13 亿美元、48.51 亿美元,净亏损分别为 26.26 亿美元、13.71 亿美元和13.51 亿美元,营收下降亏损也有所缩减;今年前六个月,营收年增 13%至 30.38 亿美元,同期间净损缩小至 3.01 亿美元,低于一年前的 5.34 亿美元亏损。

具体到业务上,格罗方德的收入来源主要为晶圆制造、工程和其他预制服务 2 项业务,2021 年前六个月,其晶圆制造业务(Wafer fabrication)收入为28.55 亿美元,占比94%,工程和其他预制服务业务收入为1.83 亿美元。招股书中特意提到其生产的单一来源产品占比正在提升,2020年,这类产品出货量占晶圆总出货量的61%,高于2018年的47%。

按地域划分,2020年,格罗方德美国区收入达33.68亿美元,占总营收比重的69.4%;包括中国台湾在内的中国区收入则达到8.48亿美元,占比17.26%;欧洲、中东和非洲收入占比9.3%。

3) 赛微: 专项出口许可申请被瑞典否决

近日,北京赛微电子股份有限公司(以下简称"公司")发表公告,指出公司于 2021 年 10 月 5 日收到 控股子公司 Silex Microsystems AB(以下简称"瑞典 Silex")管理层的通知, 瑞典 Silex 已收到瑞典战略产品检验局(the Swedish Inspectorate of Strategic Products,简称为 ISP)的正式决定并经瑞典 Silex 管理层与 ISP 现场会议确认,瑞典 Silex 于 2020 年 11 月向瑞典 ISP 提交的向公司控股子公司赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司(以下简称"赛莱克斯北京")出口与正式生产制造首批 MEMS 产品相关技术和产品的许可申请被瑞典 ISP 否决,即瑞典 ISP



阻止瑞典 Silex 继续与赛莱克斯北京进行如下交易:

(1)出口与 MEMS 制造、开 发、测试或分析设备相关的技术、软件和产品,相关技术、软件和产品可用于开 发与制造 MEMS 产品:

2)出口 MEMS 红外微测辐射热计、MEMS 加速度计、MEMS 陀螺及其相关技术。

4) 瑞萨: 车用 MCU 产能, 2023 年提升 50%以上

瑞萨在 29 日举行的经营说明会上,向外界说明该公司到 2023 年为止的生产能力展望。高阶 MCU 的前段制程供给能力,经换算成 8 寸晶圆之后约为 4 万片/月、拉抬 1.5 倍之多。主要是 因为在晶圆代工厂有确保较多的生产线。

另外在低端 MCU 的产能方面,瑞萨考虑提升到 1.7 倍、换算成 8 寸晶圆之后逾 3 万片/月,主要方法是打算透过强化自家工厂设备来达成。

瑞萨在会中也对外公开该公司 2021 年度的全年设备投资金额。那珂工厂在 2021 年 3 月发生火灾事故后的复原工程、以及回复力强化等的相关支出,合计金额估计超过 800 亿日元。 预估 2022 年度也将达到 600 亿日元水平,比起 2020 年度为止的每年 200 亿日元左右的设备投资金额要高出许多。

5) 三星 Q3 营业利润增长 28%, 宣布 2025 年量产 2nm 芯片

三星电子 (Samsung Electronics) 表示,截至 9 月份的季度营业利润可能较上年同期增长 28%, 达到 15.8 万亿韩元 (约合 132.6 亿美元)。这将是三星公司三年来最好的季度利润。上一次是 2018 年第三季度,三星公布了超过 17.5 万亿韩元的利润。三星公司本季度的综合销售额可能 会达到创纪录的 73 万亿韩元,较上年同期增长 9%。目前,三星电子没有透露包括主要盈利业 务半导体等各部门在内的具体业绩。

同时,三星于周四(10月7日)表示,将在2025年前实现2纳米晶体管工艺技术的商业化,明年上半开始生产客户设计的3纳米芯片,第二代的3纳米芯片则预期在2023年生产。

6) 北方华创第三季度营收同比高增 30%-80%

10月8日,北方华创公布2021年前三季度业绩预告。

前三季度总和:营业收入预计58亿元-66亿元,同比增长50%-72%;归属上市公司股东的净利润6亿元-7亿元,同比增长82%-117%。

第三季度:营业收入预计22亿元-30亿元,同比增长30%-80%;归属上市公司股东的净利润3亿元-4亿元,同比增长100%-180%。

业绩高增主要系:下游市场的景气,半导体装备及电子元器件业务实现持续增长。

7) 联想被终止上市

10月8日,上交所发布2021年624号公告,题为《关于终止对联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市审核的决定》(下称《决定》)。



在上述《决定》中用的是"终止"一词而非"中止"。"终止"是最终停止了,强调结果;"中止"是中途停止,强调过程中被打断,可以继续,也可以停止。从《决定》内容来看,是联想集团和保荐人主动提出在科创板上市的文件申请,现在又申请撤回不上市了。上交所官网显示,9月30日,联想集团首次公开发行存托凭证(CDR)并在科创板上市申请获受理,其本次拟公开发行不超过13.38亿份CDR,拟募集资金100亿元。

8) 9月存储器现货价格跌幅趋缓

存储器市况从下半年进入价格转折,随着现货价格第3季度跌势强劲,进入9月后各类现货价格跌幅开始趋缓,但合约价的补跌现象浮上台面,第4季度标准型DRAM跌幅可能下探至1成,NANDFlash也将转入微跌,2020第1季将可能迎来较大跌价挑战。业界预料合约价格将与现货价格靠拢拉齐。

业界认为,虽然数据中心经过2个季度的备货,库存水位逐渐上升,可能压抑后续动能,但升级需求并非减缓或停滞,主要是受到近期 IC 零组件短缺的影响。存储器大厂美光认为,第4季度 DRAM 与 NAND 维持量价齐升,但是由于 PC OEM 客户遭遇零组件短缺,将影响存储器芯片的采购,使得出货量从短期强劲变为温和下降,美光预期 1Q22 营收下滑。

展望后续价格走势,存储器模块从业者认为,消费型应用现货价格将跌至谷底,大幅走跌有望 趋缓,并延续至第4季传统电商促销旺季。而工控应用虽然也面临长短料供应问题,但工控存 储器跌幅平缓,第4季关键变量需要观察NB及其服务器相关零组件交货进度。

9) 华为哈勃再出手投资物奇微电子

9月29日,信息显示,物奇微电子的工商信息于今日发生变更,注册资本从4676.2564万元变更为5082.8874万元,同时新增股东深圳哈勃和董事何刚。增资完成后,深圳哈勃为物奇微电子第四大股东,持股8%。

物奇微电子所有芯片均基于 RISC-V 开源架构设计,是中国第一个量产 RISC-V 芯片架构并出货超千万片的芯片设计公司。该公司完全自主设计芯片的高速、低功耗、高精度的模拟接口和射频电路以及通信基带

10) ASML 上调未来十年营收预期

荷兰光刻机巨头阿斯麦 (ASML) 周三大幅上调了财务预测,并且表示,由于市场对其产品的需求旺盛,预计到 2030年,公司营收将以每年 11%左右的速度增长。

此前, 阿斯麦发布的 Q2 财报中, 营收 40.2 亿欧元, 同比增长 20.9%, 毛利率方面, 实现 50.9%, 远超公司给出的 49%毛利率指引。二季度利润总额达到 10.38 亿欧元, 略超市场预期的 10.27 亿。光刻机预定值方面, 二季度达到了 82.7 亿欧元, 创下历史记录。在未来预期上, ASML 预期 2021 年第 3 季的营收约落在 52 亿欧元到 54 亿欧元。

阿斯麦在一份声明中表示,在高利润和激烈创新的生态系统支持下,电子行业的全球大趋势预 计将继续推动整个半导体市场的增长



插图目录

图	1:	费城半导体指数持续上涨	5
		全球半导体月度销售额及增速5	
图	3:	股半导体指数5	5
图	4:	台湾半导体指数 5	5
		2021-9-17 细分板块估值情况	
图	6:	上周半导体各细分板块涨跌幅情况	5
		上周半导体行业涨跌幅前五公司	
图	8:	上周半导体行业涨跌幅后五公司	5
		A股半导体板块公司总市值(十亿元)7	
图	10:	A股半导体设计板块公司总市值(十亿元)7	7
		A股半导体设制造块公司总市值(十亿元)7	
图	12:	A股半导体设备板块公司总市值(十亿元)7	7
		A股半导体材料板块公司总市值(十亿元)7	
		A股半导体封测板块公司总市值(十亿元)7	
图	15	沪/深股通半导体板块持仓情况(按持股市值排名)	7

表格目录



分析师与研究助理简介

王芳, 电子行业首席, 曾供职于东方证券股份有限公司、一级市场私募股权投资有限公司, 获得中国科学技术大学理学学士, 上海交通大学上海高级金融学院硕士。

杨旭, 电子行业分析师, 曾供职于东方证券股份有限公司, 复旦大学理学博士。

王浩然, 电子行业分析师, 曾任职于东吴证券股份有限公司, 2019年新财富环保行业第三名团队核心成员, 获上海财经大学理学学士、金融硕士。

赵晗泥, 电子行业研究助理, 2020年加入民生电子, 曾就职于外资行业研究, 爱丁堡大学经济学硕士, 复旦大学经济学学士。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,通过合理判断并得出结论,力求客观、公正,结论不受任何第三方的授意、影响,特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明				
	推荐	分析师预测未来股价涨幅 15%以上				
以报告发布日后的12个月内公司股价	谨慎推荐	分析师预测未来股价涨幅 5%~15%之间				
的涨跌幅为基准。	中性	分析师预测未来股价涨幅-5%~5%之间				
	回避	分析师预测未来股价跌幅 5%以上				
行业评级标准						
w la 4 k + a < 1/4 40 A B b < 1 lk + b	推荐	分析师预测未来行业指数涨幅 5%以上				
以报告发布日后的 12 个月内行业指数 的涨跌幅为基准。	中性	分析师预测未来行业指数涨幅-5%~5%之间				
的瓜以阳乃至作。	回避	分析师预测未来行业指数跌幅 5%以上				

民生证券研究院:

上海:上海市浦东新区浦明路8号财富金融广场1幢5F: 200120

北京:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层; 100005

深圳:广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元; 518001



免责声明

本报告仅供民生证券股份有限公司(以下简称"本公司")的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其 为客户。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期,本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告,但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用,并不构成对客户的投资建议,并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易,亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系,并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告,则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交 易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播本报告。本公司版权所有并保留一切权利。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记,除非另有说明,均为本公司的商标、服务标识及标记。